

(1) Concerning reason 1

- Claims: 1-3, 6
- Cited references: 1-5

Cited references 1-5 describe technology for making the quantity of the metal layer on both the front and back of a two-sided printed wiring board approximately equal by providing a dummy wiring layer on it.

- Claims: 4, 6
- Cited references: 6, 7

Cited references 6 and 7 describe technology for providing, on a multi-layer wiring board, a dummy wiring layer on the same plane as the lower wiring layer in a position that spatially overlaps the upper-layer wiring.

- Claims: 5, 6
- Cited reference: 8

Cited reference 8 describes technology for providing, on the part of a printed wiring board on which semiconductor elements are mounted on the wiring layer via an insulating layer, a dummy wiring pattern that corresponds to the part directly below said semiconductor elements.

Table of cited references, etc.

1. Microfilm of utility model application S57-002922 [1982]
(unexamined utility model S58-105166 [1983])
 2. Microfilm of utility model application S59-119849 [1984]
(unexamined utility model S61-034765 [1986])
 3. Microfilm of utility model application S61-067086 [1986]
(unexamined utility model S62-178564 [1987])
 4. Unexamined patent S61-024295 [1986]
 5. Unexamined patent H01-316989 [1989]
 6. Unexamined patent H10-013003 [1998]
 7. Unexamined patent H10-275961 [1998]
 8. Unexamined patent H11-354676 [1999]
-

Record of results of search of prior technical literature

- Field searched: IPC version 7 H01L 23/12-23/15,
H05K 1/02, 3/46
- Prior art references
 - Unexamined patent S64-051697 [1989]
 - Unexamined patent H04-188886 [1992]
 - Unexamined patent H08-279680 [1996]

This record of the results of a search of the prior technical literature does not constitute grounds for rejection.

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2000-016168
起案日	平成15年12月18日
特許庁審査官	酒井 英夫 9631 4R00
特許出願人代理人	渡辺 喜平 様
適用条文	第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
2. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)**(1) 理由1について**

- ・請求項: 1-3, 6
- ・引用文献: 1-5

引用文献1-5には、両面プリント配線板にダミーの配線層を設けることによって、表裏両面の金属層の量を略等しくする技術が記載されている。

- ・請求項: 4, 6
- ・引用文献: 6, 7

引用文献6及び7には、多層配線基板において、下層配線層と同一平面上であって、上層の配線と空間的に重なる位置にダミーの配線層を設ける技術が記載されている。

- ・請求項: 5, 6
- ・引用文献: 8

引用文献8には、配線層上に絶縁層を介して半導体素子が搭載されるプリント配線板であって、該半導体素子の直下部に相当する部分にダミー配線パターンを設ける技術が記載されている。

(2) 理由2について

・請求項: 6

「幅広の配線パターン」とは、何と比較して「幅広」であるのか、その基準が不明確である。

引用文献等一覧

①. 実願昭57-002922号

(実開昭58-105166号)のマイクロフィルム

②. 実願昭59-119849号

(実開昭61-034765号)のマイクロフィルム

③. 実願昭61-067086号

(実開昭62-178564号)のマイクロフィルム

④. 特開昭61-024295号公報

⑤. 特開平01-316989号公報

⑥. 特開平10-013003号公報

⑦. 特開平10-275961号公報

⑧. 特開平11-354676号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第7版 H 0 1 L 2 3 / 1 2 - 2 3 / 1 5 ,
H 0 5 K 1 / 0 2 , 3 / 4 6

・先行技術文献 特開昭64-051697号公報
特開平04-188886号公報
特開平08-279680号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知書についてのお問い合わせ先

特許審査第三部 電子素材加工 審査官 酒井 英夫

電 話 03-3581-1101 (内線3471)

F A X 03-3580-6905